Zeitschrift: Tec21

Herausgeber: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

Band: 133 (2007)

Heft: 5: Sicher bauen

Sonstiges

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

PRODUKTE TEC21 5/2007 31

Übergewicht verursacht in Europa bereits heute eine Million Todesfälle pro Jahr. In Amerika sind zwei von drei Menschen adipös, und Übergewicht steht kurz davor, das Rauchen als wichtigste vermeidbare Todesursache abzulösen. In vielen Fällen liegt die Ursache für das Übergewicht in zunehmend ungesunden Ernährungsgewohnheiten, die ihrerseits auf Zeitmangel und die massenhafte Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln zurückgehen. Electrolux wollte diesem Trend etwas entgegensetzen und stellte Designstudenten aus aller Welt die Aufgabe, Konzepte für Küchen- und Hausgeräte zu entwickeln, die gesunde Essgewohnheiten fördern - das diesjährige Thema des «Electrolux Design Lab»-Wettbewerbs.

Die Aufgabe bestand darin, Methoden der Lebensmittelkonservierung und -zubereitung zu suchen, die den Menschen in zehn Jahren eine gesunde Ernährung ermöglichen. Die Teilnehmer erforschten die aktuellen Technologien in ihrem Arbeitsbereich und versuchten, attraktive Lösungen für den Kunden der Zukunft zu entwickeln. Mehrere hundert Designstudenten aus aller Welt nahmen am Wettbewerb teil.

PREISTRÄGER

Metin Kaplan ist der Gewinner des vierten «Electrolux Design Lab»-Preises, der kürzlich in Barcelona verliehen wurde. Der 21-jährige Student der Technischen Universität Istanbul erhielt die Auszeichnung für sein Konzept «Nevale». Es ermöglicht, unterwegs jederzeit kalte oder warme selbstgemachte Speisen zu

sich zu nehmen. Das Gerät basiert auf der Form des «Sefertasi», eines traditionellen Lebensmittelbehälters, der in den Ländern des Nahen Ostens seit Jahrhunderten verwendet wird, um zuhause zubereitete Speisen mitzunehmen. «Nevale» besteht aus übereinander gestapelten Ebenen, die bis zu vier verschiedene heisse oder kalte Speisen aufnehmen. Das digitale Display liefert Informationen zu den Lagerbedingungen für die Lebensmittel und kann so programmiert werden, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt (z.B. mittags) automatisch ein Aufwärmprozess in Gang gesetzt wird. Für kalte Speisen hält das Gerät konstant die ideale Aufbewahrungstemperatur. Jede Ebene arbeitet unabhängig, sodass heisse und kalte Speisen zusammen transportiert werden können. Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass «Nevale» sowohl aus historischer als auch aus globaler Sicht relevant sei. «Bei dem Konzept «Nevale» geht es nicht nur darum, ein bestimmtes Problem zu lösen, es fördert vielmehr eine insgesamt gesündere Lebensweise», so Henrik Otto, Leiter Electrolux Global Design.

Die Jury verlieh den zweiten und den dritten Preis an Brian Law Chuan Chai für sein Konzept «Organic Cook» und an Eduardo Altamirano Segovia für «Vessto». Der «Organic Cook» ist ein schnelles, flexibles Kochgerät für die zukünftige Küche und kommt ganz ohne Fett aus. Das Tischgerät setzt zum Garen gesunder Mahlzeiten Infrarot- und Vakuumtechnologie ein, wodurch Speisen in einem Bruchteil der Zeit zubereitet werden können, die bei traditionellen

Kochverfahren nötig wäre. «Vessto» hingegen soll zum Kochen erneuerbare Energiequellen nutzen. Im Gerät soll eine moderne Variante des Stirling-Motors zum Einsatz kommen, der mithilfe der im Kochfeld selbst produzierten Wärme kleine Gasmengen zum Expandieren und Kontrahieren anregt, was als eigentliche Energiequelle dient. Da das Gerät eine eigene Energieversorgung hat, ist kein fester Platz zum Kochen mehr erforderlich. Die neue Kochmöglichkeit soll dazu anregen, von Fertiggerichten wieder zur Eigenproduktion gesunder Mahlzeiten überzugehen – auf einem traditionellen Herd mit modernem Touch.

JURY

Fernando Campana, Architekt; Humberto Campana, Rechtsanwalt; Tetsuya Wakuda, Küchenchef; Constance Adams, Raumfahrtarchitektin; Henrik Otto, Senior Vice-President Abteilung Global Design Electrolux

FINALISTEN

Eduardo Altamirano Segovia (Universidad La Salle, Mexiko); Jonathan Assaraf (Savannah College of Art and Design, USA); Clayton Tolomiotti Rezende (Centro Universitário Positivo, Brasilien); Teeravit Hanharutaivan (King Mongkuts' Institute of Technology Ladkrabang, Thailand); Christian Jung (HFG Pforzheim, Deutschland); Metin Kaplan (Technische Universität Istanbul [ITU], Türkei); Brian Law Chuan Chai (Nationaluniversität Singapur); Kleber Puchaski (Royal College of Art, Grossbritannien); Yirong Yang (Schule für Design der Southern Yangtze University, China)

www.electrolux.com/designlab



«Nevale» (1. Preis, Metin Kaplan, Technische Universität Istanbul, Türkei)



«Organic Cook» (2. Preis, Brian Law Chuan Chai, Nationaluniversität Singapur, Singapur)



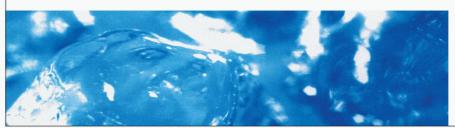
«Vessto» (3. Preis, Eduardo Altamirano Segovia, Universidad La Salle, Mexiko)





Qualität misst sich immer an den Ansprüchen der Kundschaft. Darum ist für Sie auch nur das Beste gut genug - von Linde, der Schweizer Nummer eins in der Kältetechnik!

frisch ist cool!



LKS KälteSchweiz AG Netzibodenstrasse 32 4133 Pratteln Telefon: 061 816 66 66 Telefax: 061 816 66 00 www.lks-kaelte.ch

ADRESSE DER REDAKTION

Staffelstrasse 12, Postfach 1267 8021 Zürich Telefon 044 288 90 60, Fax 044 288 90 70 E-Mail tec21@tec21.ch

WWW.TEC21.CH

REDAKTION REDAKTION
Libian Pfaff (Ip.), Chefredaktion
Ivo Bösch (bö), Wattbewerbe/Anchitektur
Claudia Carle (cc.), Umwelt/Energie
Nathale Cajacob (inc.), Redaktionsassistentin
Kathika Corts (co.), Anchitektur/Ingenieurwesen
Dariela Dietsche (dd.), Ingenieurwesen/Yerkehr
Rahel Hartmann Schweizer (rhs.), Anchitektur/Städtebau
Clementine Hegner-van Rooden (cvr.), Ingenieurwesen/Statik
Katharina Moschinger (km.), Abschlüssredaktion
Aldo Rota (an.), Bautechnik/Werkstoffe
Ruedt Werdmann (rw.) Bauneschichte Ruedi Weidmann (rw), Baugeschichte

Die Redaktionsmitglieder sind direkt erreichbar unter: Familienname@tec21.ch

REDAKTION SIA-INFORMATIONEN

Generalsekretariat SIA Selnaustrasse 16, Postfach 1884, 8027 Zürich Telefon 044 283 15 15, Fax 044 283 15 16 E-Mail contact@sia.ch Thomas Müller (tm)
Peter P. Schmid (pps)
Normen Telefon 061 467 85 74 Normen Fax 061 467 85 76

HERALISGEBERTN

Verlags-AG der akademischen technischen Vereine / SEATU Société des éditions des associations techniques universitaires Mainaustrasse 35 8008 Zürich Telefon 044 380 21 55, Fax 044 388 99 81 E-Mail seatu@smile.ch Rita Schiess, Verlagsleitung Hedi Knöpfel, Assistenz

Erscheint wöchentlich, 42 Ausgaben pro Jahr 133. Jahrgang Nachdruck von Bild und Text, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion und mit genauer Quellenangabe. Für unverlangt eingesandte Beiträge haftet die Redaktion nicht

Auflage: 10940 (WEMF-beglaubigt)

ABONNEMENTSPRETSE

ABUNNEMEN ISPRELISE
Jahresabonnement (42 Ausgaben)
Schweit: Fr. 275 – J. Ausland: Fr. 360. – J Euro 232 –
Studierende CH. Fr. 138. – J. Studierende Ausland: Fr. 223. – J Euro 144. –
Halbjahresabonnement (21 Ausgaben)
Schweit: Fr. 153. – J. Ausland: Fr. 195. 50 J Euro 126. –
Studierende CH. Fr. 75. – J. Studierende Ausland: Fr. 118.50 J Euro 76. –
Schweiter Fo. 30 J Montaget Fr. 231. Schweiz: Fr. 20.- | Ausland: Fr. 32.- | Euro 21.-

Ermässigte Abonnemente für Mitglieder BSA, Usic und ETH Alumni. Weitere auf Anfrage, Telefon 031 300 63 44

ABONNENTENDIENST

Stämpfli Publikationen AG Postfach 6326 3001 Bern Telefon 031 300 63 44. Fax 031 300 63 90 E-Mail abonnemente@staempfli.com

Adressänderung für SIA-Mitglieder: mutation@sia.ch

EINZELBESTELLUNGEN

Einzelnummer (Bezug beim Aboni Fr. 12.- | Euro 8.- (ohne Porto) nnentendienst)

INSERATE

KünzlerBachmann Medien AG Postfach, 9001 St. Gallen Telefon 071 226 92 92, Fax 071 226 92 93 E-Mail info@kbmedien.ch www.kbmedien.ch

DRUCK

GESTALTUNGSKONZEPT

Integral Ruedi Baur, Zürich | Claudia Wildermuth

BEIRAT

Hans-Georg Bächtold, Liestal, Raumplanung Heinrich Figi, Chur, Bauingenieurwe Markus Friedli, Frauenfeld, Architektur Erwin Hepperle, Bubikon, öff. Recht Roland Hürlimann, Zürich, Baurecht Daniel Meyer, Zürich, Bauingenieurwesen Ákos Morávanszky, Zürich, Architekturtheorie Ulrich Pfammatter, Burgdorf, Technikgeschichte Franz Romero, Zürich, Architektur

TRÄGERVEREINE

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, SIA www.sia.ch

TEC21 ist das offizielle Publikationsorgan des SIA. Die Fachbeiträge sind Publikationen und Positionen der Autoren und der Redaktion. Die Mitteilungen des SIA befinden sich jeweils in der Rubrik «SIA»

Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieur-Unternehmungen, usic www.usic-engineers.ch

und Absolventen der ETH Zürich, ETH-Alumni www.alumni.ethz.ch

Bund Schweizer Architekten, BSA

Association des diplomés de l'EPFL

VERANSTALTUNGEN TEC21 5/2007 38



NEAT - EINE SCHWEIZER PIONIERLEISTUNG

Ausstellung des Museums für Ingenieurbaukunst im Hänggiturm in Zusammenarbeit mit AlpTransit zu den neuen Alpentransversalen. Anhand von Schautafeln, Modellen und Originalprojekten wird die Entstehung der Neat spannend und anschaulich dargestellt.

Ort: Lichthof des Baudepartements, Basel Zeit: bis 23. Februar 2007, Mo-Fr 8-18 h

Infos: www.siabasel.ch

ANLASS BESCHREIBUNG INFOS/ANMELDUNG

AUSSTELLUNG

«Projektwettbewerbe im offenen Verfahren: Altersheim Köschenrüti, Altersheim Trotte» Das Amt für Hochbauten führte parallel zwei Projektwettbewerbe im offenen Verfahren durch. Ziel war es, Realisierungsvorschläge für zwei Altersheime zu erhalten bis 4.2.2007 | Mo-Fr 16-20 h, Sa/So 14-18h Ausstellungsraum UG Hallenbad Oerlikon, Zürich www.stadt-zuerich.ch/hbd

VORTRAGSREIHE «Das Detail: Buol & Zünd»

Das Detail stellt im Entwurfsprozess eine besondere Herausforderung dar. Buol & Zünd haben eine Entwurfsstrategie entwickelt, bei der historische und handwerkliche Aspekte die architektonischen Themen prägen 6.2.2007 | 18.30 h Fri-Art, Fribourg www.fri-archi.ch

SEMINAR «Planungsseminar Minergie-P»

Inhalt: Minergie-P-Philosophie; Architektur, Gebäudehülle, Bauphysik, Haustechnik; Minergie-P in der Sanierung; praktische Beispiele; Neuheiten, Trends, Erkenntnisse

28.2. / 1.3.2007

Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau, Biel Anmeldung bis 9.2. unter: www.hausbaumesse.ch

AUSSTELLUNG «Farbatlas Zürich» Wie grau oder wie bunt ist Zürich? Mittels Farbabnahmen, Fotografien etc. wird die spezifische Farbigkeit eines Quartiers und das Gesamtkolorit der Stadt Zürich ermittelt bis 22.4.2007 | Di-So 10–17 h, Do bis 20 h Gewerbemuseum Winterthur www.gewerbemuseum.ch



TRACÉS 1/2007 17.1.2007 REPENSER

LA SUISSE

Bulletin technique de la Suisse romande Rue de Bassenges 4 1024 Ecublens Tél. 021 693 20 98 Fax 021 693 20 84 E-mail Secrétariat; fdc@revue-traces.ch

www.revue-traces.ch



VORSCHAU NR. 6 5.2.2007 REPARIERT

Entlastet
Rahel Hartmann Schweizer
LC+Perret =
Schweizer Moderne
Michael Hanak
Geistige Leistungen
und Patente
Daniel Kündig

TEC21-ABO BESTELLEN: TEL. 031 300 63 44 ODER WWW.TEC21.CH